

证券代码：300689

证券简称：澄天伟业

编号：2026-004

深圳市澄天伟业科技股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称/人员姓名	参加澄天伟业 2025 年度业绩说明会的投资者
时间	2026 年 04 月 29 日 15:00-16:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长/总经理：冯学裕 独立董事：兰才明 独立董事：韩燕 独立董事：周红 财务负责人/董事会秘书：蒋伟红
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司 2025 年归母净利润达到 1537.16 万元，同比增长 32.83%。推动全年业绩高增的核心驱动力主要来自哪些业务板块？可持续性如何？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！2025 年公司业绩实现稳健增长，核心驱动力主要来自半导体封装材料业务和传统智能卡业务的共振。全年实现营业收入 4.14 亿元，同比增长 15.01%；归母净利润 1537.16 万元，同比增长 32.83%，扣非净利润较上年同期亏损 64.55 万元实现扭亏，达到 716.30 万元，同比增长 1,209.75%。</p> <p>具体分业务来看，半导体业务 2025 年实现收入 6109.35 万元，同比大幅增长 62.38%，已成为公司业绩增长的重要驱动力。公司半导体产品主要包括柔性引线框架及封装、冲压引线框架，其中冲压引线框架业务保持较快发展。这一高速增长态势主要受益于新能源汽车、光伏储能及工业控制等领域对国产功率半导体的旺盛需求，公司凭借稳定的产品性能持续获得客户认可。</p> <p>从经营质量来看，2025 年经营活动产生的现金流量净额为 4879.01 万元，同比增长 56.04%，归母净资产为 6.95 亿元，较上年末增长 2.62%。在可持续性方面，半导体业务伴随国产替代趋势和公司产能扩张，预计将继续保持增长；智</p>

能卡业务虽已进入成熟期，但仍能提供稳定的收入和现金流支撑。整体来看，公司增长结构正在从单一依赖向多元化驱动转变。感谢您的关注！

2、液冷散热是公司当前的战略重点和新增长极，请您介绍一下目前客户突破到产业化落地的具体进展如何？

答：尊敬的投资者您好！公司液冷散热产品主要服务于数据中心、算力基础设施的散热需求，主要产品包括液冷管路、分水器、液冷板、快速接头等。目前公司液冷产品已完成多轮技术验证，并已获得部分客户的样品测试认证。报告期内，公司持续推进液冷产品的工程化落地和核心客户量产导入，建立项目研发及量产产线，具备机加工、焊接、组装、清洗检测等全流程制造能力，相关产线已具备满足现阶段客户交付需求。在2026年定增预案中，公司也计划将部分募集资金主要用于投入该基地的产能扩建，以进一步满足未来市场与客户的增长需求。感谢您的关注！

3、2025年公司半导体业务同比增长超过60%，维持了出色的成长节奏。请教一下该业务的产能规划、目标市场以及盈利趋势。

答：尊敬的投资者您好！2025年半导体业务收入6109.35万元，同比增长62.38%。产品包括柔性引线框架、模块及冲压引线框架，公司冲压引线框架产品可覆盖MOSFET、IGBT、SiC封装需求，并通过IATF16949认证，面向新能源汽车、工业电源、光伏储能等领域，其发展较快，产能利用率保持在较高水平。根据公司2026年定增预案，半导体封装材料扩产项目是募集资金的重要投向之一，预计建成后将进一步提升公司高端引线框架和高导热铜针式散热底板等的产能配套能力，规模效应有望推动毛利率改善。感谢您的关注！

4. 公司2026年拟通过向特定对象发行股票募资不超过8亿元，用于液冷散热、半导体封装材料及研发中心等建设。请问该事项的审批进展、产能规划依据及具体必要性？

答：尊敬的投资者您好！公司在2026年1月17日披露了《2026年度向特定对象发行A股股票预案》。本次定增旨在顺应AI基础设施和半导体先进封装快速发展的产业趋势，拟募集资金总额不超过8亿元。具体投向上，本次募集资金计划主要用于三个方向：液冷散热系统产业化项目（拟投入3.62亿元）、液冷研发中心及集团信息化建设项目（拟投入1.14亿元）、半导体封装材料扩

产项目（拟投入 2.62 亿元）及补充流动资金。产能规划的决策依据主要基于行业趋势判断、下游终端需求增长预判，以及现有核心客户合作进展及未来订单需求。

本次募资的必要性主要体现在几个层面：第一，AI算力密度爆发式提升带来了液冷模块与高导热封装材料需求的确定性增长；第二，高端引线框架及液冷存在国产替代空间；第三，全球供应链优质产能紧张，公司亟需建设自有产能以满足核心客户的大规模交付要求。公司定增方案已于 2026 年 2 月经临时股东大会审议通过，后续尚需深圳证券交易所审核通过并获中国证监会同意注册后方可实施。感谢您的关注！

5、智能卡业务是公司原有的核心业务，但传统实体卡市场增长空间有限。请问公司传统业务未来如何规划？

答：尊敬的投资者您好！智能卡业务多年为公司提供稳健现金流。尽管实体卡市场整体步入存量阶段，但该市场并非萎缩，而是趋于成熟与精细化发展，在身份认证、金融安全及万物互联领域需求仍具刚性。2025 年公司智能卡业务仍实现 2.85 亿元收入，同比增长 5.63%，持续为公司提供稳定的营收和优良的现金流。公司正推动业务向服务方向升级以提升毛利，未来整体规模预计维持稳定。感谢您的关注！

6、我想请教一下总体的风险视角。公司转型进入液冷与半导体封装材料等核心科技领域，肯定会面临行业竞争加剧、产能建设和管理等一系列挑战。公司如何看到这些风险？

答：尊敬的投资者您好！公司高度重视经营管理过程中可能面临的各类风险，并已建立系统化的风险管理体系。从行业风险看，半导体封装材料和液冷散热领域存在技术迭代快速、客户验证周期长等特征，公司通过持续加大研发投入（2025 年研发费用同比增长 6.46%）、构建自主知识产权体系、与客户共同开发前瞻性布局来巩固技术壁垒。公司经过多年发展，已形成一支覆盖经营管理、技术研发、工程制造、市场开拓及运营保障等方面的核心团队，能够较好把握行业竞争特征、客户需求变化及业务推进节奏，并在经营管理、资源协调、项目落地和客户服务等方面发挥重要作用。

在经营风险管控方面，公司重点应对三方面挑战：1) 技术更新风险，通过建

立集团顶层创新机制，实现跨部门技术协同，公司已与部分客户建立了较为紧密的前期开发合作关系，2025年在惠州建设液冷生产中心，能够在保障产品质量和交付效率的基础上，更快响应客户需求变化。2) 原材料波动风险，通过主要原材料零库存、优化供应商配置、集中采购、套期保值等手段建立避险机制。3) 为把握下游应用扩展及高密度算力基础设施发展机遇，公司制定了专项扩产计划应对措施：液冷散热系统产业化项目（拟投入 3.62 亿元）、液冷研发中心及集团信息化建设项目（拟投入 1.14 亿元）、半导体封装材料扩产项目（拟投入 2.62 亿元）及补充流动资金，持续推动业绩增长结构从单一依赖向多元化驱动转变。感谢您的关注！

7、董事长您好！2025 年公司完成了董事会换届，董事会成员由 5 名调整为 7 名，并推出了员工持股计划。请问公司在完善公司治理方面还有哪些举措？

2025 年公司分红政策如何？未来在股东回报方面有何规划？

答：尊敬的投资者您好！公司于 2025 年 12 月召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》和相关治理制度。根据《公司法》及最新监管要求，公司不再设置监事会及监事岗位，原由监事会行使的职权转由董事会审计委员会履行。公司董事会由 5 名董事调整为 7 名董事，包括 3 名非独立董事、3 名独立董事和 1 名职工代表董事，进一步完善了董事会结构，提升了公司治理效能。

2025 年公司推出了员工持股计划，截至报告期末，公司回购专用证券账户持有 1,005,070 股，占公司总股本的 0.87%，用于员工持股计划。该计划旨在优化员工薪酬结构，建立长期激励体系，发挥公司人才的主观能动性。根据规定，员工持股计划持有人放弃表决权，仅保留出席权、提案权及分红等经济权利。公司坚持“稳健之中求发展”的经营策略，在重视对投资者合理投资回报的同时兼顾公司可持续发展。2025 年公司实现营业收入 4.14 亿元，同比增长 15.01%；归属于上市公司股东的净利润 1,537 万元，同比增长 32.83%，经营业绩稳步提升。公司同时披露利润分配预案，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税）。感谢您的关注！

8、请问公司如何平衡短期业绩压力与长期战略投入？

答：尊敬的投资者您好！公司锚定长期战略方向，坚持“智能卡+半导体+液冷”

三轮驱动发展。当前短期利润波动主要源于液冷散热新业务的投入及股份支付费用增加，但智能卡主业稳健、半导体材料快速增长，并为公司提供了持续现金流。公司谨慎控制经营风险与财务风险，通过“以销定产”控制库存、动态优化研发支出；同时用好资本市场融资工具，拟通过定向增发募集不超过8亿元分担成本；通过实施员工持股计划等制度安排，逐步完善长效激励机制，将核心团队利益与公司长期发展深度绑定，确保战略执行的持续性和稳定性。公司采取灵活的产能投放节奏，分阶段、分批次推进，在确保核心业务健康运转的同时，稳步推进液冷散热等长期战略布局，力求实现短期经营与长期价值的平衡。感谢您的关注！

9. 公司拟向特定对象发行股票募资不超过8亿元，投向半导体封装材料和液冷散热业务，请问两个项目的具体投资金额、建设期是多少？达产后预计营收与净利情况怎么样？

答：尊敬的投资者您好！公司在2026年1月17日披露了《2026年度向特定对象发行A股股票预案》。本次定增旨在顺应AI基础设施和半导体先进封装快速发展的产业趋势，拟募集资金总额不超过8亿元。具体投向上，本次募集资金计划主要用于三个方向：液冷散热系统产业化项目（拟投入3.62亿元、建设期30个月）、液冷研发中心及集团信息化建设项目（拟投入1.14亿元、建设期36个月）、半导体封装材料扩产项目（拟投入2.62亿元、建设期30个月）及补充流动资金。产能规划的决策依据主要基于行业趋势判断、下游终端需求增长预判，以及现有核心客户合作进展及未来订单需求。目前定增方案已于2026年2月经临时股东会审议通过，后续尚需深圳证券交易所审核通过并获中国证监会同意注册后方可实施。公司具体经营业绩信息敬请关注公司后续披露定期报告。感谢您的关注！

10、年报提到半导体业务营收高增，请问公司在半导体封装材料领域的核心技术壁垒是什么？与国内同行相比的技术差距及追赶计划？

答：尊敬的投资者您好！公司在半导体封装材料领域构建了多维技术壁垒，主要体现在以下方面：（1）材料性能方面：具备导热性、延展性、热膨胀匹配等核心参数优化能力；（2）工艺精度方面：掌握高密度精细图形加工、电镀均匀性及键合可靠性等表面处理技术；（3）垂直整合能力：拥有从材料到结

	<p>构件的全流程制造体系，包括高精度化学蚀刻、钎焊等核心工艺；（4）系统解决方案：已从单一材料供应商发展为提供“封装材料+热管理结构件+液冷模块系统解决方案”的综合服务商。</p> <p>与国内同行相比，公司半导体封装材料产品主要应用于功率器件，产品可覆盖 MOSFET、IGBT、SiC 及功率模块等产品的封装需求。目前公司正积极向头部功率模块及工装企业推广铜针式散热底板产品，以满足新能源汽车、光伏逆变器等领域的应用需求。同时，公司围绕高功率密度器件散热需求，持续推进微通道封装盖板（MLCP）等下一代先进封装散热材料的研发与验证工作，并与相关客户开展联合开发与应用导入。公司坚持技术创新和市场开拓，不断提升在高端封装材料领域的技术水平和国产化配套能力，以把握进口替代和产业升级带来的结构性发展机遇。感谢您对公司的关注！</p> <p>11、2025 年国内数字经济、数据中心建设加速，公司液冷散热业务实现营收 49.26 万元，请问该业务是否符合国家算力基础设施政策导向？后续扩产节奏是否受政策审批影响？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！公司液冷散热业务符合国家算力基础设施政策导向。根据 2026 年 1 月 17 日披露的《2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》，国家近年来出台多项政策支持行业发展，包括：2023 年 2 月国务院《数字中国建设整体布局规划》提出优化算力基础设施布局；2024 年 7 月发改委《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》明确推广液冷技术应用；2025 年 8 月国务院《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》进一步强化 AI 与算力融合发展的战略方向。这些政策为液冷业务创造了良好的发展环境。</p> <p>关于扩产节奏，公司正在推进的液冷散热系统产业化项目（拟投入 3.62 亿元）和研发中心建设项目（拟投入 1.14 亿元）均严格遵循国家产业政策要求。目前定增方案已于 2026 年 2 月经临时股东会审议通过，后续尚需深圳证券交易所审核通过并获中国证监会同意注册后方可实施。公司将持续关注政策动态，确保产能扩张与市场需求、政策导向保持同步协调。感谢您对公司的关注！</p>
<p>风险提示</p>	<p>公司提醒新业务新产品开发过程中存在一定的技术风险、市场风险和应用验证周期风险，上述内容如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关信息，不视作公司或公司管理层对行业、公司发展的承诺与保证，公司将严格按照有关</p>

	法律法规的要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
附件清单(如有)	无
日期	2026-4-29